

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2019-042

无锡上机数控股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开第二届董事会第十六次会议，于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于拟签署包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公司的议案》，同意公司出资设立全资子公司（暂定名弘元新材料包头有限公司，具体名称以工商部门登记为准）。

上述事项具体情况，详见2019年5月8日、2019年5月18日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于拟签署包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-035）、《无锡上机数控股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。

经包头市青山区市场监督管理局核准，相关子公司最终注册登记名称为弘元新材料（包头）有限公司，并于近日领取了《营业执照》。

弘元新材料（包头）有限公司工商登记信息如下：

名称：弘元新材料（包头）有限公司；

统一社会信用代码：91150204MA0Q8QY28L；

类型：一人有限责任公司；

住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区管委会A座516室；

法定代表人：杨昊；

注册资本：伍亿（人民币元）；

成立日期：2019年05月20日；

营业期限：自2019年05月20日至2039年05月19日；

经营范围：半导体材料、石英材料、石墨材料、碳碳材料、半导体设备、太

太阳能设备的研发、制造、销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019年5月31日